

NO	発表開始時間	発表終了時間	会場	セッションNO	座長	セッション名	演題名	氏名	所属
0045	9:50	10:10	A	6A1-1	田口 博久 (中京大学)	高速高周波実装技術・電磁特性技術-1	絶縁エネルギー伝送用コイルの軸ずれに対する伝送特性	○坂本世成, 越地福朗	東京工科大学大学院
0020	10:10	10:30	A	6A1-2	田口 博久 (中京大学)	高速高周波実装技術・電磁特性技術-1	前部に配置する通信用スパイラルコイルの位置ずれに対する伝送特性の検討	○市川達夫, 越地福朗	東京工科大学
0014	10:30	10:50	A	6A1-3	田口 博久 (中京大学)	高速高周波実装技術・電磁特性技術-1	人体通信の電波伝搬通信に対する優位性の検討	○品川陽斗, 越地福朗	東京工科大学大学院
0050	11:05	11:25	A	6A2-1	日浦 滋 (日浦技術士事務所)	高速高周波実装技術・電磁特性技術-2	伝送路の電磁界シミュレーションにおける励振源と計算精度	○大島 大輔	日本アイ・ピー・エム
0032	11:25	11:45	A	6A2-2	日浦 滋 (日浦技術士事務所)	高速高周波実装技術・電磁特性技術-2	誘電率測定用円板共振器の高精度化	○馬路哲	住ベリサーチ
0015	13:05	13:25	A	6A3-1	新宮原 正三 (関西大学)	めっき技術-1	液相析出法によるスズ酸化物を中間層に用いたガラス基板のめっき密着性	○田中真一, 廣岡あすか, 妹尾俊作, 遠水雅仁, 坂田俊彦, 長尾敏光, 片山順一	奥野製薬工業, パナソニック環境エンジニアリング
0026	13:25	13:45	A	6A3-2	新宮原 正三 (関西大学)	めっき技術-1	エキシマランプを用いた高周波対応樹脂に対する無電解銅めっき膜の密着性向上	○有本 太郎, 三浦 真純, 竹元 史敏	ウシオ電機
0027	13:45	14:05	A	6A3-3	新宮原 正三 (関西大学)	めっき技術-1	測定の測定に基づく硫酸銅めっき液の精製および皮膜品質予測	○古賀淑智, 坂田義太郎, 寺崎正	産業技術総合研究所
0011	14:20	14:40	A	6A4-1	池田 慎吾 (大阪産業技術研究所)	めっき技術-2	無電解CuWB皮膜の高周波バリア性能評価	○佐村哲也, 伊井義人, 小田幸典, 橋本滋雄	上村工業
0075	14:40	15:00	A	6A4-2	池田 慎吾 (大阪産業技術研究所)	めっき技術-2	有機シラン処理を用いたSiO ₂ 上の極薄無電解Ni膜の平滑化	○山田 尚生, 齊藤 文晴, 岡本尚樹	大阪公立大学大学院
0034	9:50	10:10	B	6B1-1	西川 宏 (大阪大学)	インターコネク-1	セルフアライメント可能な焼結型接合材料	○乙川光平, 中矢清隆	三菱マテリアル
0040	10:10	10:30	B	6B1-2	西川 宏 (大阪大学)	インターコネク-1	ニッケルナノ粒子-アルミニウムマイクロ粒子接合材を用いた大気加熱による高耐熱接合	○小柴佳子, 眞宏平	早稲田大学
0073	10:30	10:50	B	6B1-3	西川 宏 (大阪大学)	インターコネク-1	反応性スパッタリングによるTi系MAX合金薄膜の物性に及ぼすA元素の効果	○上田 和真, 若松 和伸, 岡本 尚樹, 齊藤 文晴	大阪公立大学大学院
0024	11:05	11:25	B	6B2-1	日暮 栄治 (東北大学)	インターコネク-2	キュア過程におけるCNT系導電性ペーストと銅電極間の界面抵抗解析	○辻村那, 井上雅博	群馬大学大学院
0041	11:25	11:45	B	6B2-2	日暮 栄治 (東北大学)	インターコネク-2	Al ₂ O ₃ 原子層堆積 (ALD) 膜の表面活性化接合	○王 俊沙 ¹ , 多喜川 良 ² , 須賀 竜知 ¹	¹ 明星大学, ² 九州大学
0077	11:45	12:05	B	6B2-3	日暮 栄治 (東北大学)	インターコネク-2	Microstructural Characterization of Weak Micro-Via by Electron Microscopy	Ming-chun HSIEH ¹ , Zheng ZHANG ¹ , Masahiko NISHIJIMA ¹ , Jayun YEON, Aiji SUETAKE ¹ , Chenchuantong CHEN ¹ , Hiroyoshi Yoshida ¹ , Toshiyuki KAN ² , Hidekazu HONNMA ² , Takushi MATSUMAMI ² , Kuniaki OTSUKA ² , Yuhei KITAHARA ² , Koji KITA ² , Yu SHIMIZU ² and Katsuki SUGANUMA ¹	¹ Flexible 3D System Integration Lab, SANKEN, Osaka University, ² Okuno Chemical Industries Co. Ltd.
0036	13:05	13:25	B	6B3-1	岩田 剛治 (大阪大学)	インターコネク-3	高周波加熱を利用した非接触はんだづけ技術の開発	○坂井 雄一, 熊田 泉実, 清水 孝晃, 高柳 毅, 石橋 大輔 ²	¹ 富山県産業技術開発センター, ² スフィンクス・テクノロジー
0048	13:25	13:45	B	6B3-2	岩田 剛治 (大阪大学)	インターコネク-3	液体金属Gaを用いた接合部の熱疲労破壊特性および熱劣化特性	○改原 グスタヴォ ヨウスケ, 笠巻 利雄, 朝日 純介, 竹田 龍世, 山中 公博	中京大学
0064	13:45	14:05	B	6B3-3	岩田 剛治 (大阪大学)	インターコネク-3	複雑学習を活用した高給はんだ接合条件の効率的探索	○苅谷 健人, 浮田 昌也, 大塚 拓一, 中原 健	ローム
0033	14:20	14:40	B	6B4-1	平井 義和 (京都大学)	マイクロメカトロニクス実装技術	ポスト駆動回路を用いた24.15GHzマイクロ波加熱のためのマイクロ流体デバイスの開発	○藤谷海斗 ¹ , 岸原亮佳 ¹ , 山口明啓 ¹ , 内海裕一 ¹	¹ 兵庫県立大学, ² 岡山県立大学
0043	14:40	15:00	B	6B4-2	平井 義和 (京都大学)	マイクロメカトロニクス実装技術	圧電素子の振動を用いたマイクロローラーの開発	○阪本 千絵 ¹ , 阿部 優希 ¹ , 仁木 雄哉 ¹ , 武田 健嗣 ¹ , 栗原原 剛 ¹ , 金子 美泉 ¹ , 内木 文男 ¹	日本大学
0066	15:00	15:20	B	6B4-3	平井 義和 (京都大学)	マイクロメカトロニクス実装技術	電子機器の廃熱利用を目的とした低沸点液体とシリコンチップによる有機ランキンサイクル発電機	○仁木雄哉 ¹ , 阿部優希 ¹ , 阪本千絵 ¹ , 武田健嗣 ¹ , 栗原原剛 ¹ , 金子美泉 ¹ , 内木文男 ¹	日本大学
0007	9:50	10:10	C	6C1-1	山中 公博 (中京大学)	パワーエレクトロニクス実装技術-1	電力半導体ダイアタッチ部における疲労劣化ネットワーク構築と熱抵抗の関係	○金井 宏喜 ¹ , 苅谷 義治 ¹ , 三須 俊幸 ¹ , 越智 光樹 ¹ , 花田 隆一郎 ² , 出尾 晋一 ²	¹ 芝浦工業大学, ² 三菱電機
0009	10:10	10:30	C	6C1-2	山中 公博 (中京大学)	パワーエレクトロニクス実装技術-1	電力半導体モジュールダイアタッチ接合部のパワーサイクル中の破壊形態と破壊駆動力	○平島 祐也, 苅谷 義治	芝浦工業大学
0031	10:30	10:50	C	6C1-3	山中 公博 (中京大学)	パワーエレクトロニクス実装技術-1	顕微鏡分光法による多層電極付n型β-Ga ₂ O ₃ 結晶の高周波状態における熱応力解析に関する研究	○各務貞哉, 須田 潤	中京大学大学院
0016	11:05	11:25	C	6C2-1	出田 吾朗 (三菱電機)	パワーエレクトロニクス実装技術-2	遷移的液相結晶法(TLPS)を用いたダイオード接合部の高周波信頼性の検討	○池田端 ¹ , 中村真人 ² , 福井昭一 ²	¹ 日立製作所, ² 日立パワーデバイス
0047	11:25	11:45	C	6C2-2	出田 吾朗 (三菱電機)	パワーエレクトロニクス実装技術-2	次世代パワー半導体実装を想定したCu ₃ Sn実装接合を	○福地 孝平 ¹ , 大口 健一 ¹ , 中野 貴斗 ¹ , 黒沢 善吾 ¹ , 瀬田 敏子 ²	¹ 秋田大学, ² 秋田県産業技術センター
0017	11:45	12:05	C	6C2-3	出田 吾朗 (三菱電機)	パワーエレクトロニクス実装技術-2	Cuを微量添加したAg薄膜を用いた大気中の原子拡散接合法における接合性能	○渡部 雄真, 魚本 幸, 島津 武仁	東北大学
0055	13:05	13:25	C	6C3-1	山口 敏史 (パナソニックインダストリー)	パワーエレクトロニクス実装技術-3	パワーエレクトロニクスに向けたCu-Pd合金系接合部のCuの挙動	○根本 俊介, 八坂 慎一, 三橋 雅彦	神奈川県立産業技術総合研究所
0018	13:25	13:45	C	6C3-2	山口 敏史 (パナソニックインダストリー)	パワーエレクトロニクス実装技術-3	パワーデバイスにおける封止樹脂と金属基板界面の接着信頼性への影響因子の検討	○加々良剛志 ¹ , 中川 稔 ² , 池田 徹 ¹	¹ 住友ベークライト, ² 鹿児島大学
0037	13:45	14:05	C	6C3-3	山口 敏史 (パナソニックインダストリー)	パワーエレクトロニクス実装技術-3	繰り返し4点曲げ試験で得られるパワーモジュール用アルミワイヤボンド部のワイヤリフトオフ寿命と非弾性ひずみ幅の関係	○加藤 雅也 ¹ , 坂口 智紀 ¹ , 小倉 正明 ¹ , 矢野 信之 ² , 池田 徹 ¹ , 葉山 裕 ³ , 萩原 世也 ³ , 宮崎 則幸 ³	¹ 鹿児島大学, ² 近畿大学, ³ 佐賀大学
0076	14:20	14:40	C	6C4-1	門口 卓也 (デンソー)	パワーエレクトロニクス実装技術-4	AEC (音響)法を用いたダイアタッチ構造部の欠陥発生とその環境測定と劣化診断の取り組み	○末武 武士 ¹ , 強政 ¹ , 藤田 トウ ¹ , 片山 理 ² , 杉浦 和彦 ² , 藤田 和弘 ³ , 菅沼 克昭 ¹	¹ 大阪産業科学研究所, ² ミライズテクノロジー, ³ デンソー
0049	14:40	15:00	C	6C4-2	門口 卓也 (デンソー)	パワーエレクトロニクス実装技術-4	Cu/Ni-P/Sn-5Sb-0.7Cu はんだ接合部エレクトロマイグレーションの電流密度加速性	○和田 有史, 小島 航平, 長谷川 航大, 山中 公博	中京大学
	9:50	10:00	D	6D1-1	塚原 法人 (パナソニックHD)	JEITA 2022年度版実装技術ロードマップ	はじめに：ロードマップの経緯と概要紹介	○森 得人	パナソニックHD
	10:00	10:10	D	6D1-2	塚原 法人 (パナソニックHD)	JEITA 2022年度版実装技術ロードマップ	注目される市場と電子機器群	○西村 隆	三菱電機
	10:10	10:30	D	6D1-3	塚原 法人 (パナソニックHD)	JEITA 2022年度版実装技術ロードマップ	ヒューマンサイエンス	○深澤 秀幸	日立製作所
	10:30	10:50	D	6D1-4	塚原 法人 (パナソニックHD)	JEITA 2022年度版実装技術ロードマップ	情報通信	○森 得人	パナソニックHD
	11:05	11:25	D	6D2-1	塚原 法人 (パナソニックHD)	JEITA 2022年度版実装技術ロードマップ	モビリティ	○西村 隆	三菱電機
	11:25	11:45	D	6D2-2	塚原 法人 (パナソニックHD)	JEITA 2022年度版実装技術ロードマップ	新技術・新材料・新市場	○鈴木 理	ナミックス
	11:45	12:05	D	6D2-3	塚原 法人 (パナソニックHD)	JEITA 2022年度版実装技術ロードマップ	脱炭素社会実現を支える電子部品の動向	○川崎 哲生	パナソニック インダストリー ㈱
	13:05	13:45	D	6D3-1	塚原 法人 (パナソニックHD)	JEITA 2022年度版実装技術ロードマップ	CPS(Cyber-Physical Sstem)の進展に向けて多様化が加速する電子デバイスパッケージ	○尾崎 裕司	ナミックス
	13:45	14:05	D	6D3-2	塚原 法人 (パナソニックHD)	JEITA 2022年度版実装技術ロードマップ	世界の製造現場を支える日本の実装設備	○前田 憲	パナソニックコネクタ
	14:20	15:00	D	6D4-1	塚原 法人 (パナソニックHD)	JEITA 2022年度版実装技術ロードマップ	プリント配線技術ロードマップ ~新規事業機会の創生~	○宇都宮 久修	インターコネクション・テクノロジー
	15:00	15:05	D	6D4-2	塚原 法人 (パナソニックHD)	JEITA 2022年度版実装技術ロードマップ	おわりに	○森 得人	パナソニックHD
基調講演	15:30	16:30	U	6U1-1	森裕幸 (日本アイ・ピー・エム)	基調講演	金属3Dプリンティングによる組織・結晶配向制御と高機能化	○中野 貴由	大阪大学
基調講演	16:30	17:30	U	6U1-2	森裕幸 (日本アイ・ピー・エム)	基調講演	SDN (Software Defined Networking)とは何だったか	○河野 美也	シスコシステムズ合同会社